

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2008年9月4日 (04.09.2008)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2008/105137 A1

- (51) 国際特許分類:
B24B 37/00 (2006.01) B24B 37/04 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2008/000100
- (22) 国際出願日: 2008年1月29日 (29.01.2008)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2007-046760 2007年2月27日 (27.02.2007) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 信越半導体株式会社 (Shin-Etsu Handotai Co., Ltd.) [JP/JP]; 〒1000004 東京都千代田区大手町二丁目6番2号 Tokyo (JP). 不二越機械工業株式会社 (Fujikoshi Machinery Corp.) [JP/JP]; 〒3811233 長野県長野市松代町清野1650番地 Nagano (JP).

(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 北川幸司 (KITA-GAWA, Koji) [JP/JP]; 〒9618061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平150番地信越半導体株式会社半導体白河研究所内 Fukushima (JP). 上野淳一 (UENO, Junichi) [JP/JP]; 〒9618061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平150番地信越半導体株式会社半導体白河研究所内 Fukushima (JP). 小林修一 (KOBAYASHI, Syuichi) [JP/JP]; 〒9618061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平150番地信越半導体株式会社半導体白河研究所内 Fukushima (JP). 工藤秀雄 (KUDO, Hideo) [JP/JP]; 〒9618061 福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平150番地信越半導体株式会社半導体白河研究所内 Fukushima (JP). 宮下忠一 (MIYASHITA,

Tadakazu) [JP/JP]; 〒3811233 長野県長野市松代町清野1650番地不二越機械工業株式会社内 Nagano (JP). 鍛冶倉俣 (KAJIKURA, Atsushi) [JP/JP]; 〒3811233 長野県長野市松代町清野1650番地不二越機械工業株式会社内 Nagano (JP). 西本吉伸 (NISHIMOTO, Yoshinobu) [JP/JP]; 〒3811233 長野県長野市松代町清野1650番地不二越機械工業株式会社内 Nagano (JP).

(74) 代理人: 好宮幹夫 (YOSHIMIYA, Mikio); 〒1100005 東京都台東区上野7丁目6番11号第一下谷ビル8F Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

(54) Title: POLISHING APPARATUS

(54) 発明の名称: 研磨装置

(57) Abstract: Provided is a polishing apparatus comprising a lower stool (12), a motor (18a) and a speed reducer (19a) for driving the lower stool, and a box (17) for covering at least the portion of the lower stool below the working action face. The polishing apparatus polishes a wafer by forcing the wafer to contact the lower stool and by rotating the lower stool. The box has its inside separated by partitions (31a and 31b) into a plurality of regions, and the motor for driving the lower stool is arranged in a region other than the region containing the lower stool. The polishing apparatus can manufacture a wafer of a stable shape, irrespective of the time elapsed from the running start and the presence/absence of the stop of the polishing apparatus.

(57) 要約: 本発明は、少なくとも、下定盤(12)と、前記下定盤を駆動するためのモーター(18a)及び減速機(19a)と、少なくとも前記下定盤の加工作用面より下の部分を覆うボックス(17)とを具備し、前記下定盤にウエーハを圧接し、前記下定盤を回転させて前記ウエーハを研磨する研磨装置において、前記ボックス内が、隔壁(31a、31b)で複数の領域に分離されており、前記下定盤を駆動するモーターが、前記下定盤が含まれる前記領域とは異なる領域に配置されている研磨装置である。これにより、研磨装置の運転開始からの経過時間や停止の有無にかかわらず、安定した形状のウエーハを製造可能な研磨装置が提供される。

WO 2008/105137 A1